

## 縦型両面露光装置 光 FE205C

## ソルダーレジスト用半自動露光装置 SRE110S

### ■ ソルダーレジスト用半自動露光装置 SRE110S

#### 【特長】

- 多品種小ロット  
ダブルテーブル  
レーザーポインタ  
自動フィルム枠開閉装置
- 高精度アライメント  
新画像処理方式（エッジ抽出方式）  
新4点按分方式（2点アライメントも対応可能）  
高剛性機台
- 高精度露光  
楔型真空接合方式

#### 【仕様】

- 基板サイズ：幅×奥行200×200～640×560mm  
板厚0.06～3.0mm
  - 光源：拡散光 10kWメタルハライドランプ  
照度分布…80%以上  
初期照度…55mW/cm<sup>2</sup>以上  
冷却方式…水冷式
  - 位置合わせ：基板概略合わせ…レーザーポイント式  
マーク認識方式…新型画像処理方式  
アライメント方式…新4点按分方式  
繰返し位置決め精度…±5μm以下  
露光位置合わせ精度…±10μm以下
  - 機台寸法：1400 (W) ×3100 (D) ×2000 (H) mm
  - 機台重量：約1500kg
  - オプション：平行光光源  
リモートメンテナンスシステム
- ※パターン用半自動露光機も製作致します。



### ■ 縦型両面露光装置 光 FE205C

#### 【特長】

- 高精度アライメント  
新画像処理方式（エッジ抽出方式）／新4点按分方式  
高剛性機台
- 高精度露光  
楔型真空接合方式
- 省スペース  
縦型構造を最大限生かした機台寸法  
機台重量当社従来機比20%ダウン  
機台搬入時分割式化
- 高信頼性  
完全数値制御システム／新型搬送パット装置  
省配線システム／モニタリングシステム  
リモートメンテナンスシステム（オプション）

#### 【仕様】

- 基板サイズ：幅×奥行 330×250～610×510mm  
板厚 0.06～3.0mm（3.0mm以上も対応可能）
- 光源：平行光 5kWショートアークランプ  
照度分布…85%以上  
初期照度…28mW/cm<sup>2</sup>以上  
冷却方式…空冷式
- 位置合わせ：プリアライメント…非接触式（光学式検出方式）  
マーク認識方式…新型画像処理方式（エッジ抽出方式）  
アライメント方式…新4点按分方式  
繰返し位置決め精度…±5μm以下  
露光位置合わせ精度…±10μm以下
- 機台寸法：3300 (W) ×2525 (D) ×2180 (H) mm
- 機台重量：約4000kg
- オプション：HEPAフィルター付きダウンプロー装置  
温湿度コントロール装置／薄板・FPC対応  
露光部イオナイザー装置／反射式照明  
リモートメンテナンスシステム



**Howa**

豊和工業株式会社

本社工場 〒452-8601 愛知県西春日井郡新川町須ヶ口  
機械事業部営業グループ  
E-mail : denshi@howa.co.jp  
TEL(052)408-1261(ダイヤルイン)  
FAX(052)400-7108/409-3766  
URL <http://www.howa.co.jp>

東京事務所 〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目2番15号  
大阪事務所 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋3番31号  
TEL(03)3573-3621(代表)  
TEL(06)6943-1211(代表)